

DAWON NEXVIEW

Micro 기술로 Macro 세상을 변화시키는 다원넥스뷰



World Wide Business

| World Best Product

| World First Process

DISCLAIMER

본 자료는 투자자들을 대상으로 실시하는 IR Presentation에서의 정보 제공을 목적으로 주식회사 다원넥스뷰(이하 “회사”)에 의해 작성되었습니다.

본 자료에 포함된 “예측정보”는 개별 확인 절차를 거치지 않은 정보들입니다. 이는 과거가 아닌 미래의 사건과 관계된 사항으로 회사의 향후 예상되는 경영환경 및 재무실적을 의미하고, 표현상으로는 ‘예상’, ‘전망’, ‘계획’, ‘기대’, ‘E’, ‘F’ 등과 같은 단어를 포함합니다.

위 “예측정보”는 향후 경영환경의 변화 등에 따라 영향을 받으며, 시장상황에 따라 대내외적인 불확실성을 내포하고 있는 바, 실제 미래 실적은 “예측정보”에 기재되거나 암시된 내용과 중대한 차이가 발생할 수 있습니다.

또한, 향후 전망은 Presentation 실시일 현재를 기준으로 작성된 것이며, 현재 시장상황과 회사의 경영목표 등을 고려한 것으로 시장환경의 변화와 전략수정 등에 따라 별도의 고지없이 변경될 수 있음을 양지바랍니다.

본 자료의 활용과 관련하여 발생하는 손실에 대해서 회사 및 회사의 임직원들은 과실 및 기타의 경우를 포함하여 그 어떠한 책임도 부담하지 않음을 알려드립니다. 본 문서는 주식의 모집 또는 매출, 매매 및 청약을 위한 권유를 구성하지 아니하며 문서의 그 어느 부분도 관련 계약 및 약정, 투자 결정을 위한 기초자료가 될 수 없습니다.

본 자료는 비영리 목적으로 내용 변경 없이 사용이 가능하고 (단, 출처표기 필수), 회사의 사전 승인없이 내용이 변경된 자료의 무단 배포 및 복제는 법적인 제재를 받을 수 있음을 유념하여 주시기 바랍니다.



스마트폰으로 QR 코드를 인식하시면,
홈페이지, 기업설명회 영상 확인 및 IR 자료를
다운로드 하실 수 있습니다.



GLOBAL TOP
LASER MICRO-PROCESS
SOLUTION PROVIDER

Summary

- 회사 개요

- 주요 제품 소개

- 우호적 시장 환경

- 글로벌 시장 진출 현황

- 회사 연혁

- 핵심 제품 경쟁력

- 차세대 친환경 공법

- 비즈니스 로드맵

Company & Business

- 주요 사업 영역

- 신성장 동력

- AI 생태계 진입

- 기술 경쟁력 요약

- 전방 시장 현황

- 중국 시장 확대 본격화

초정밀 마이크로 레이저 접합 장비 전문기업 다원넥스뷰



대표이사 남 기 중

- 연세대학교 물리학과 학사, 석사, 박사
- University of Emory / Post Doc
- 고등기술연구원 / 레이저 응용 기술 센터장
- ㈜제이스텍 CTO / 사업본부장 겸
- ㈜다원넥스뷰 대표이사 (2010.07~ 현재)
- 2019년 벤처창업진흥유공 표창장
- 2021년 무역의날 수출의탑 수상
- 2022년 장영실상 수상
- 2023년 세계일류상품 인증서 수상
- 2023년 대한민국 우수특허 대상
- 2024년 벤처창업진흥 유공 산업포장 수상

회사 개요

기업명	주식회사 다원넥스뷰
대표이사	남기중
설립일	2009년 11월 20일
자본금	76억원
사업분야	레이저 응용 장비 개발 제조(마이크로 접합/가공)
임직원수	70명 (2025.05 기준)
본사 소재지	경기도 안산시 단원구 시화호수로 485
홈페이지	www.nexview.co.kr

인증 및 수상 현황

2019 벤처창업진흥유공 중소벤처기업부	2022 수출의탑 한국무역협회	2022 장영실상 과학기술정보통신부	2023 대한민국 우수특허 대상 한국특허정보원 한국일보	2023 세계일류상품 인증서 산업통상자원부 kotra	2024 벤처창업진흥 유공 산업포장 중소벤처기업부
-----------------------------	------------------------	---------------------------	--	---	--------------------------------------

기술성평가

AA

지식재산권
(28건 등록, 8건 출원)

36

국책과제

13

선도적인 연구와 개발로 혁신의 역사 지속

2009~2013

설립기

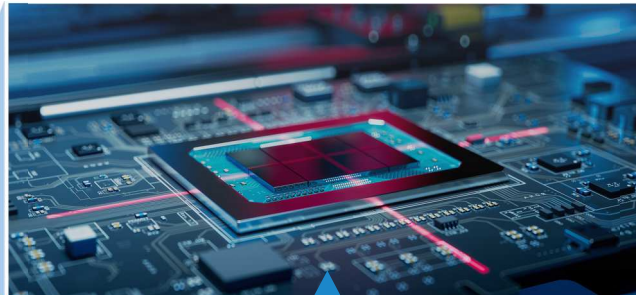


LSMB 핵심 기술 형성기
스마트폰, 자동차 전장 시장 중심

- 2013 Laser Micro-Soldering 장비 납품 (스마트폰 스피커/리시버 양산)
- 2011 기업 부속 연구소 설립
- 2010 Laser Micro-Soldering 기술 개발 (스마트폰, 자동차 전장 시장 진입 기술)
- 2009 법인 설립

2014~2018

구축기



pLSMB 기술 개발 / 제품 출시
(반도체 테스트 공정 시장 본격 진입)
sLSMB 기술 개발

- 2018 Laser Micro-Solder Ball Jetting 기술 개발 (반도체 패키징 공정 시장 진입 기술, sLSMB)
- 2017 Laser Micro-Bonding 장비 납품 (국내 및 세계 1위 프로브카드사 Formfactor)
- 2016 Laser Micro-Soldering 장비 납품 (현기차 초음파센서 양산)
- 2015 Laser Micro-Soldering 장비 납품 (현기차 주차보조센서 인라인 양산)
- 2014 Laser Micro-Bonding 기술 개발 (반도체 테스트 공정 시장 진입 기술, pLSMB)

2019~

성장기

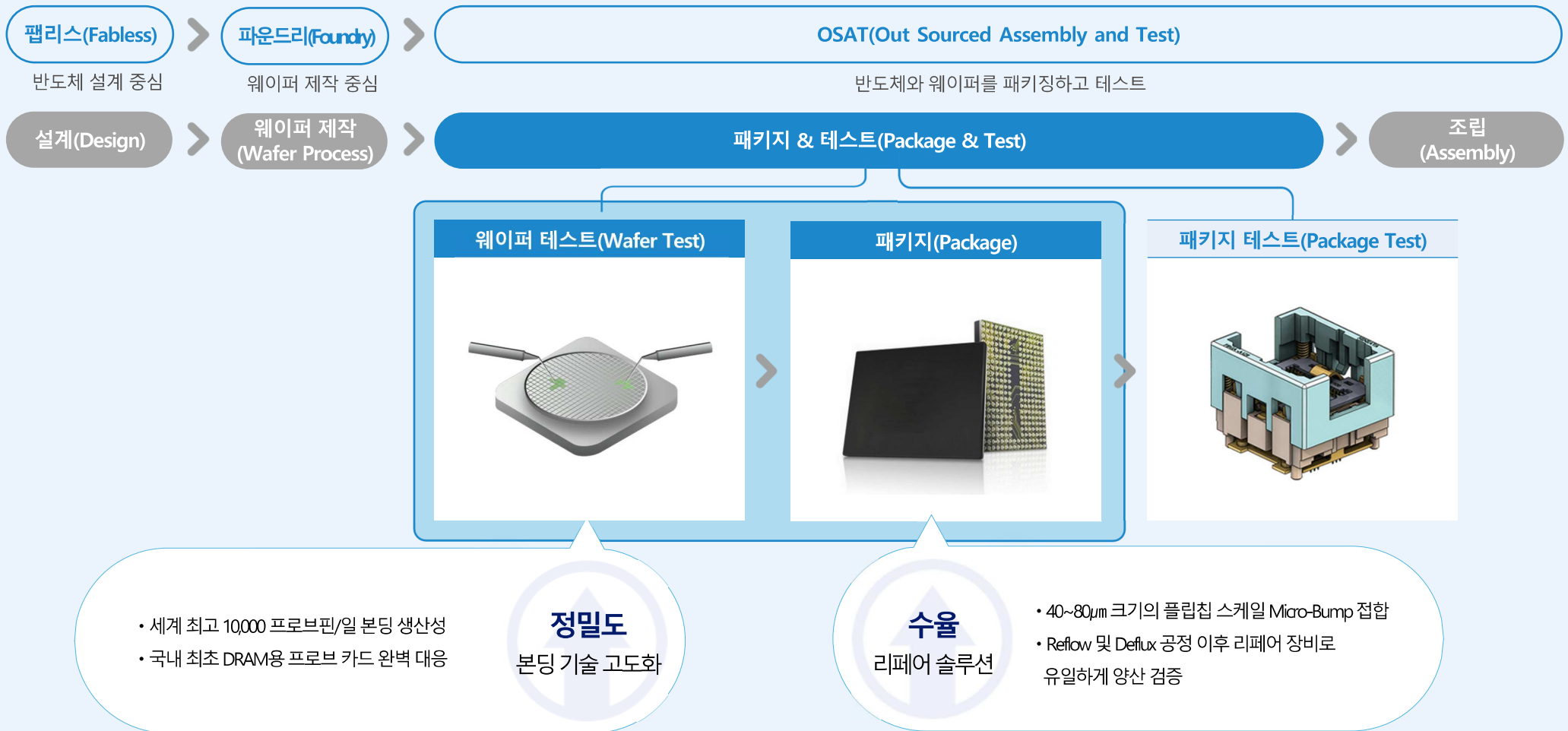


pLSMB 제품 판매처 확대 및 수출 본격화
sLSMB 제품 출시
(반도체 패키징 공정 시장 본격 진입)

- 2024 코스닥 상장
남기중 대표이사 벤처창업진흥유공 산업포장 수상
3백만불 수출의탑 수상
- 2023 세계일류제품 인증서 수상 (산업통상자원부/KOTRA)
대한민국 우수특허 대상 수상 (건설/기계 부문)
- 2022 장영실상 수상 (Laser Micro-Bonding System)
차세대 Laser Micro-Bonding 장비 납품 (국내 최초 DRAM용 High Speed Bonder)
- 2021 백만불 수출의탑 수상
Laser Micro-Bump Mounter 장비 납품 (세계 최초 FC-BGA 반도체 기판 양산 라인 적용)
- 2020 Laser Micro-Bonding System Turn-Key 납품 (중국 메모리용 프로브카드 시장 본격 진출)
- 2019 코넥스 상장 (A323350)
벤처활성화 유공 표창 (중소벤처기업부)
Probe Card Assembly Process Full 자동화 완성 (Probe Cutting, Inserting, Inspection, Repair)

03. 주요 사업 영역

고정밀도와 높은 수율을 구현하는 웨이퍼 테스트와 패키지 접합 장비 사업 영위

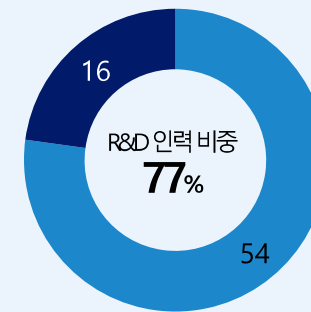


자료 : 반도체 제조 과정과 반도체 업종의 연관(©한울출판사/photographSENSATA)

세계 최고 수준의 초정밀 레이저 마이크로 본딩 기술 'LSMB'; Laser Systemic Micro-Bonding Technology



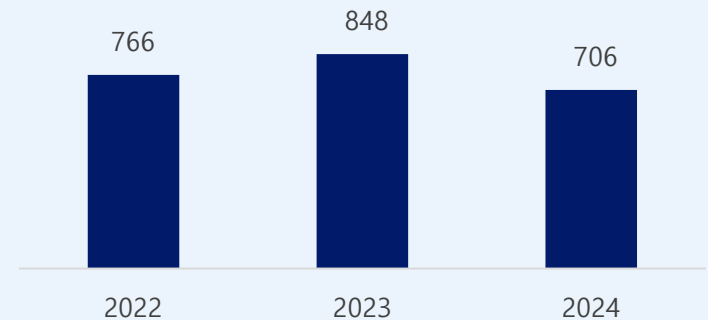
■ R&D 인력 ■ 그 외 직원 수



석박사급 (10명)
14%

3개년 R&D 투자 현황

(단위: 백만원)



반도체 테스트/패키징 공정에 적용되는 레이저 마이크로 접합 공정 솔루션 보유

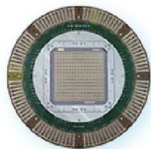
LSMB

* LSMB: Laser Systemic Micro-Bonding

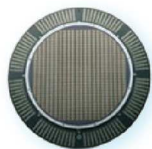
pLSMB

반도체 테스트 부문

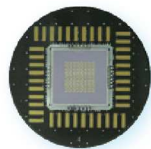
메모리 및 비메모리 웨이퍼 테스트용
고속/고정밀 프로브카드 탐침 접합 장비



DRAM



NAND FLASH

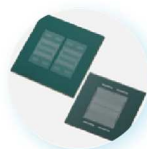


CIS

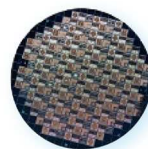
sLSMB

반도체 패키징 부문

패키징 기술 고도화(Chiplet화/대면적화)에 대응하는
첨단 마이크로 솔더볼 범핑 공정 장비



Flip Chip
Substrate



FI, FO-WLP

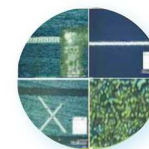


BGA/Camera
Module

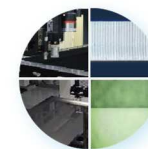
dLSMB

차세대 디스플레이 부문

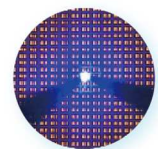
차세대 디스플레이용
마이크로 LED 리페어 솔루션



Solar Cell
Scribing



UTG Cutting



Micro LED
Repair

반도체 초미세 접합 공정에 필요한 원천 기술 확보 및 공정 자동화 장비 라인업 구축

pLSMB 반도체 테스트 16건
(등록13/출원 3)

프로브카드 제조 공정 자동화장비



Probe Cutting System



Probe Insert System



Laser Micro-Bonding System



Wafer Inspection System



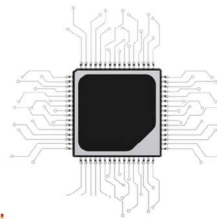
Laser Micro-Repair System



High Speed Bonder

sLSMB 반도체 패키징 12건
(등록12)

반도체 기판 범핑 공정 자동화장비



Laser Solder Ball Jet System



Laser Bump Repair System



Micro-Solder Bump Laser Repair System

dLSMB 디스플레이 8건
(등록3/출원5)

첨단 디스플레이/신에너지 공정 자동화장비



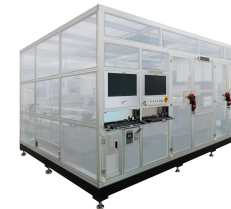
UTG (Ultra Thin Glass) Cutting System



Perovskite Laser Scribing System



Busbar Film Strip System



FMM (Fine Metal Mask) Repair & Cutting System



06. 핵심 제품 경쟁력 1 (pLSMB_프로브카드 탐침 접합)

DRAM·HBM 모두 대응 가능한 차세대 프로브카드 본딩 솔루션

DRAM 프로브카드 CAPA 부족에 대한 대안



Before HSB: DRAM 및 HBM 테스트 장비의 국산화율 낮음, 대부분 수입에 의존



After HSB

세계 최고의
프로브 본딩 생산성

- 40 μ m 이하의 프로브 핀을 12인치 기판에 $\pm 5\mu$ m 이내 오차로 접합
- 일일 최대 10,000 Probe 본딩 접합, 기존 대비 생산성 30% 향상
- 국내 최초 DRAM용 프로브 카드 완벽 대응, 중국시장 선점



DRAM은 물론, HBM용 고밀도
2D MEMS 프로브카드도 본딩
가능한 유일한 설비

sLSMB 기반 리페어 + *CPO용 BGA 범프 마운터로 라인업 확장

고성능 기판 리페어 및 패키징 시장 Solder ball 접합 기술 선점

NVIDIA

Apple

BROADCOM

intel

AMD

글로벌 CPU, GPU 제조사

fabrinet

SAMSUNG 삼성전기

IBIDEN SHINKO

Unimicron

NANYA 景碩科技

臻鼎科技集團 Zhen Ding Tech. Group

Substrate Supplier/OSAT

DAWON NEXVIEW

솔루션 제공



Laser Bump
Mounter_BGA



Laser Bump
Mounter_FC

기존 솔더볼 장비는 미세화 대응에 한계, 수십만 개 중 하나만 탈락해도 전체 수율에 중대한 영향

제품 개발 및 양산
적용 승인 완료

- 시간당 5만 bph 처리 속도, 기존 대비 4배 ↑
- 복수의 글로벌 CPU 제조사 양산 적용 및 승인
- 세계 유일의 회로에 따른 레시피 자동 설정 DB
- 400~700um급 솔더볼 스마트폰 부품 실장 시장 진입

세계 최초 솔더볼 접합 투트랙 체제 완성

40μm급 리페어 장비 +
100μm 이상 솔더볼을 시간당
5만발 실장하는 광통신
모듈용 장비까지 확보

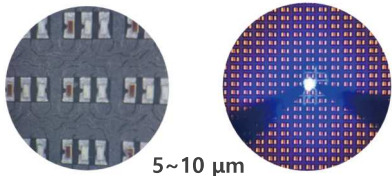
*CPO(Co-Packaged Optics)

기존 반도체는 물론 첨단 디스플레이 및 차세대 Solar cell 시장을 중심으로 사업 확대

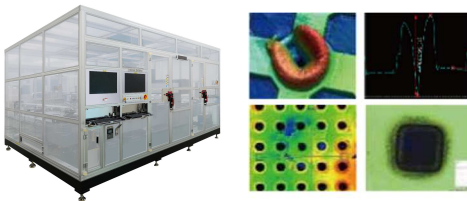
01 dLSMB

- 리페어 공정의 공대 불량, 레이저로 미세 홀 재형성
- FMM 국산화 및 uLED Assembly 공정 수율 증가

마이크로 LED 리페어



FMM 리페어



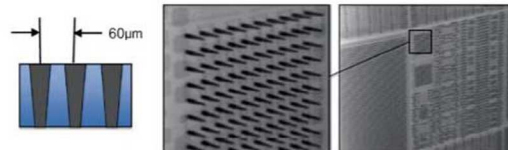
02 UTG Cutting System & 2.5D Packaging

- 폴더블 및 플렉서블 디스플레이용 UTG 형상 가공 장비 개발 진행
- 차세대 반도체인 글라스 인터포저 장비 개발 진행

Full Auto UTG Cutting



Glass Substrate Interposer Cutting/Drilling



자료: Metalized TGV X-ray Images (Dai Nippon Printing)

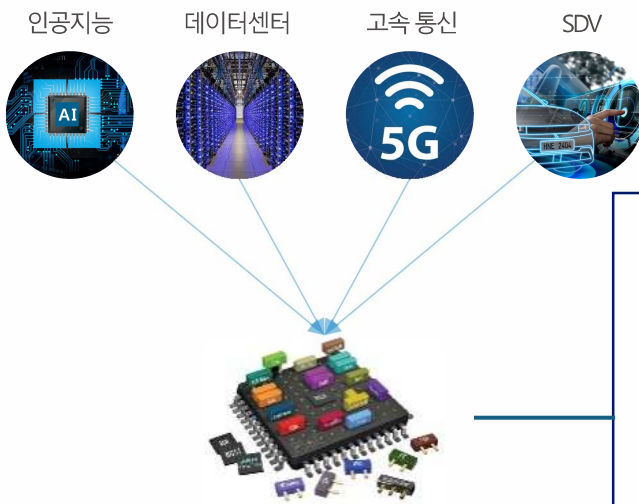
03 Laser Scribing System

- 실리콘을 대체할 차세대 소재인 페로브스카이트 솔라셀 장비까지 제품군 확대

Solar Cell Laser Scribing



고집적·고성능 반도체 수요 확대에 의한 고도화된 첨단 반도체 기술 요구



테스트 공정
고도화

- 단위 면적 당 입출력 단자 개수 증가 및 간격 감소
- 웨이퍼 테스트 환경의 미세화 및 복잡도 증가
- 초정밀 테스트 위한 MEMS 프로브카드 수요 증가

패키지 공정
고도화

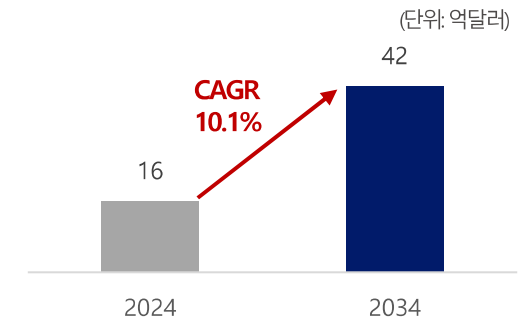
- 기판에 더 많은 전기 신호 채널 필요
- 단자 간 피치 최소화 위한 범프 크기 축소 요구
- 마이크로 솔더블이 적용되는 FC-BGA 수요 증가

고집적화 → SoC 복잡도 증가

초미세화 → 수율 이슈 발생

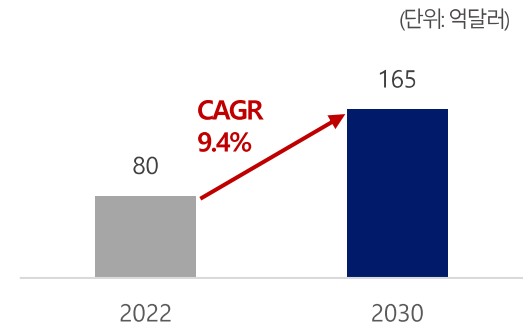
고성능화 → 전력/열/신호 무결성 확보 난이도 증가

글로벌 MEMS 프로브 카드 시장 규모



*출처: Market.us(2025)

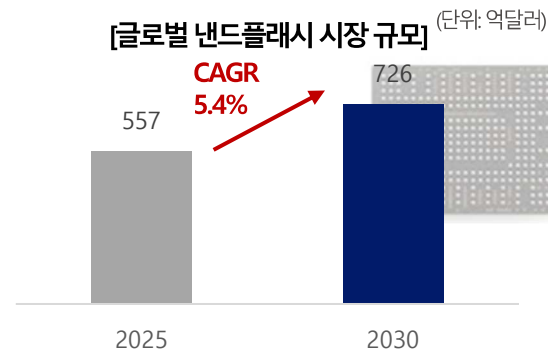
글로벌 FC-BGA 시장 규모



*출처: 후지카메라종합연구소

핵심 전방 시장 고성장, NAND·DRAM·HBM 수요 확대에 따른 장비 수혜 본격화

NAND 시장 회복세로 테스트 장비 투자 수요 증가



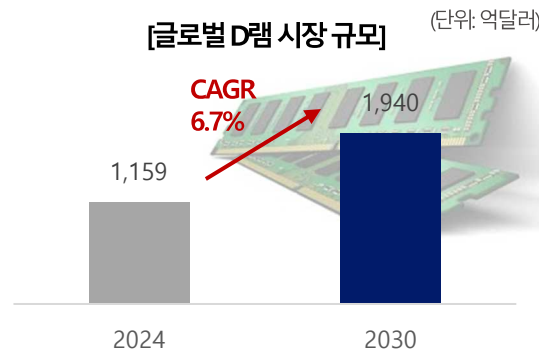
자료: 글로벌인포메이션(2025)

美 관세 정책 불확실성에 따른
메모리 선제 비축 수요 증가

낸드 가격 회복세 지속 및
3Q25 최대 10% 상승 전망

AI학습/추론 증가로
기업용 SSD 중심 수요 확대

DRAM 국산화 확대 등 정밀 장비 수요 증가



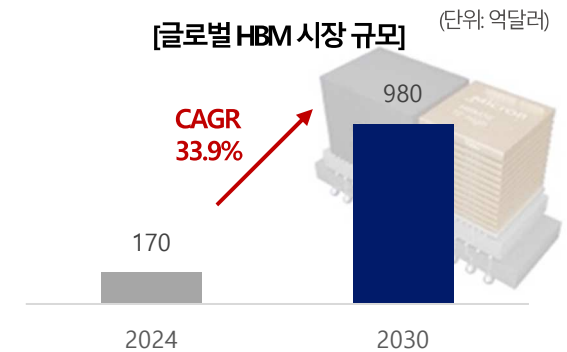
자료: 포춘비즈니스인사이트(2025)

AI/서버 수요 반등으로 범용
메모리 가격 큰 폭(22%↑) 상승

국내 주요 메모리사의 선단 공정 도입,
고부가 제품(DDR5 등) 전환 가속

고속/고용량 D램 확대로
테스트 장비 정밀도 요구 증가

3D 적층/고대역폭 대응 위한 HBM 전용 테스트 장비 수요 폭증



자료: 윌그룹

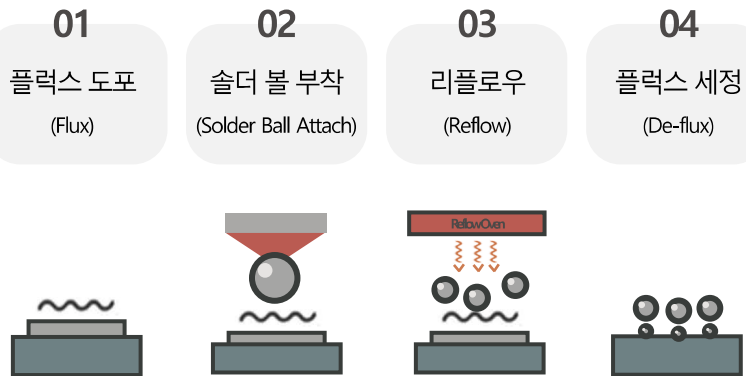
AI 앱 확산과 고대역폭/저전력 HBM
수요 급증으로 고난도 테스트 공정 필수

글로벌 빅테크 중심의 공급망 재편,
전용 테스트 장비 수요 확대 본격화

메모리 3사 올 하반기 HBM4 12단,
내년 상반기 HBM4 16단 양산 본격화

레이저를 활용한 친환경 공법 적용으로 새로운 시장 진입 기대

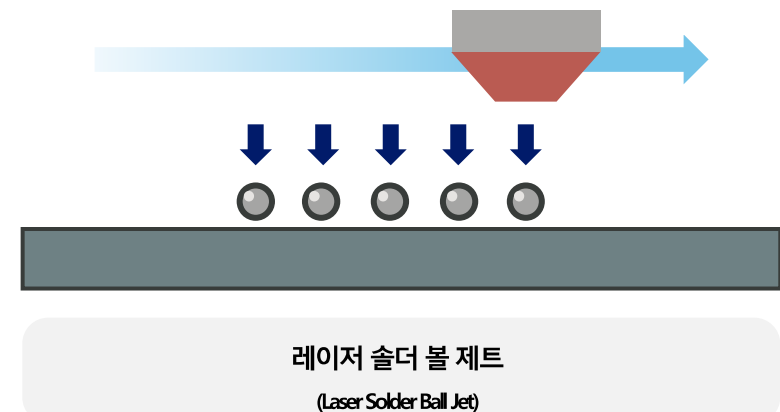
기존 공정



기존 플럭스 도포 방식은 접착력 향상 효과는 있으나, 챔버 오염 및 후속 세정 공정 필요로 생산 효율성 제약



One Step Flux Free 공법



무플럭스 접합 기술 및 직접 솔더 볼 부착 방식 적용으로 도포·세정 등 공정 단일화를 통한 생산 효율성 극대화 실현

메모리 업계에 플럭스리스 본딩 기술 적용 적극 추진 등 수요 급속히 확산 중

전자신문 2024.11.13

HBM4용 신규 접합 '플럭스리스 본딩' 급부상

디지털데일리 2025.02.12

HBM4 공정 '플럭스리스 본딩' 부상... 하이브리드 본딩 대체 관건 [소부장반차장]

Net Korea 2025.03.10

삼성·TSMC가 주목한 CPO 패키징... '플럭스리스 본딩' 적용 기대

글로벌 AI 생태계 본격 진입, 글로벌 빅테크 레퍼런스 확보로 성장 가속화

☞ sLSMB 사업 신규 시장 선점

sLSMB LBM_BGA (Laser Bump Mounter_BGA)

글로벌 AI 광통신 제조사
(시총 84.2억\$)



fabrinet



NVIDIA

(유럽계 주요 경쟁사 대비 기술 우위로 엔비디아 품질 검증 통과)

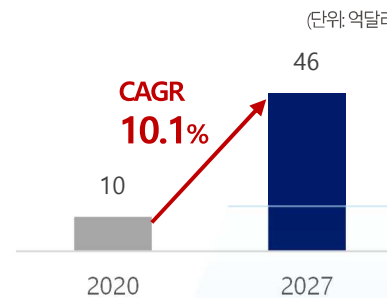
- 엔비디아 向 AI GPU의 서버간 초고속 광통신 모듈 개발 공정에 적용
- 시간당 5만 발의 솔더볼을 처리할 수 있는 세계 최고 수준의 접합 속도
- 고속 고정밀 레이저를 활용한 One Step Flux Free 친환경 공법 채택



엔비디아 차세대 GPU 초도 생산 파트너 선정 및
추가 선적 예정으로 글로벌 AI 시장 선점 기회 확보

☞ CPO 시장 현황 및 진출 확대 전략

글로벌 실리콘 포토닉스 시장 규모



*출처: Broadcom(2025)

폭발적인 데이터 처리 수요 등
GPU 간 대역폭 급증

광학 기술 기반 데이터 전송 및
차세대 병렬 처리의 핵심

기존 대비 에너지 효율 개선과
운영 비용 대폭 절감

글로벌 AI
광통신 공급망
진입 가속화

CPO 특화 장비
중심 포트폴리오
다변화

커스터마이징
역량 강화 및
케파 증설 추진

12. 중국 시장 확대 본격화

中 반도체 장비 수요 확대에 따른 맞춤형 수출 전략 전개 中

pLSMB 사업 중국 본격 진출

pLSMB HSB-D (High Speed Bonder Dual)



중국 국영 종합무역회사



33억원 규모
공급 계약체결
(24년 매출 17% 규모)

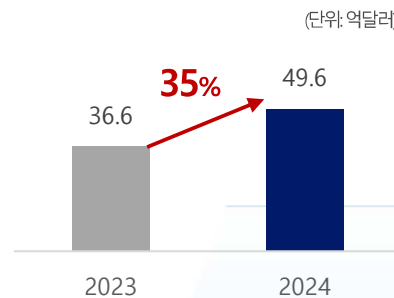
- 하루 최대 1만개의 프로브 핀 접합 가능한 고속 장비
- 기존 장비 대비 생산성과 품질 안정성 대폭 향상
- 중국 거대 유통 네트워크 확보 및 AI-HBM용 DRAM 수요 대응



현지기업과장기적협업으로아시아시장입지강화

中 반도체 시장 동향 및 진출 확대 전략

중국 반도체 제조장비 투자 규모



*출처: SEMI

지난해 중국 해외 수입 반도체 장비 규모 사상 최대치 기록

미 정부 규제 강화
선제적 반도체 장비 비축

반도체 내재화로 고속/고정밀
자동화 장비 니즈 증가

중국 내 대리점
및 거점 확보로
현지 대응력
강화

품질 인증 기반
대형 고객사
대상 영업 확대

아시아 및
중화권을 넘어
글로벌 전개
가속화

13. 글로벌 시장 진출 현황

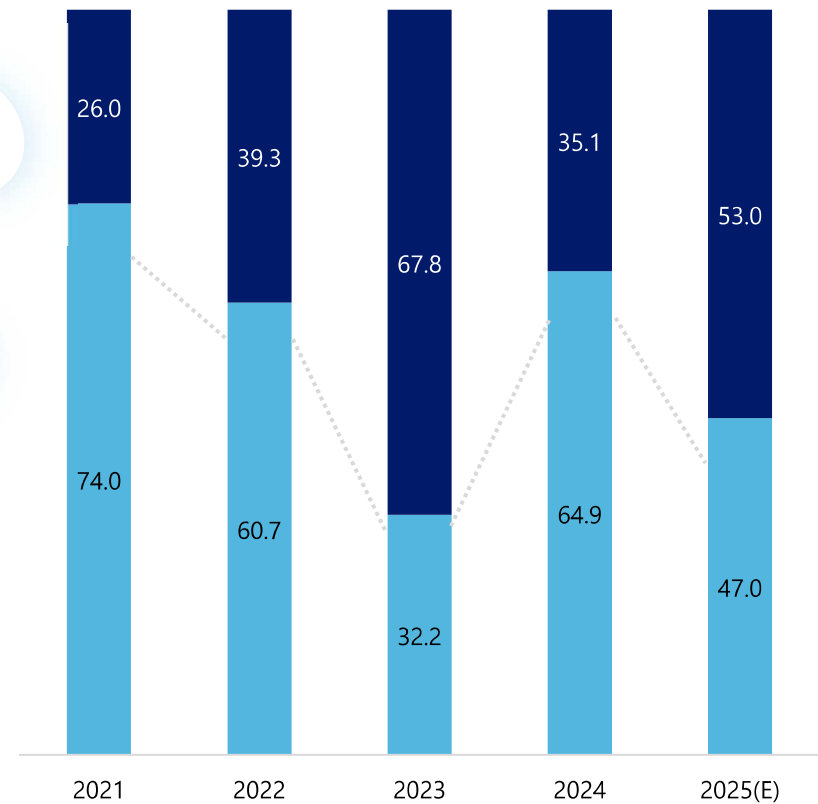
글로벌 AI 시장 성장에 따른 핵심 솔루션 공급으로 해외 진출 가속화



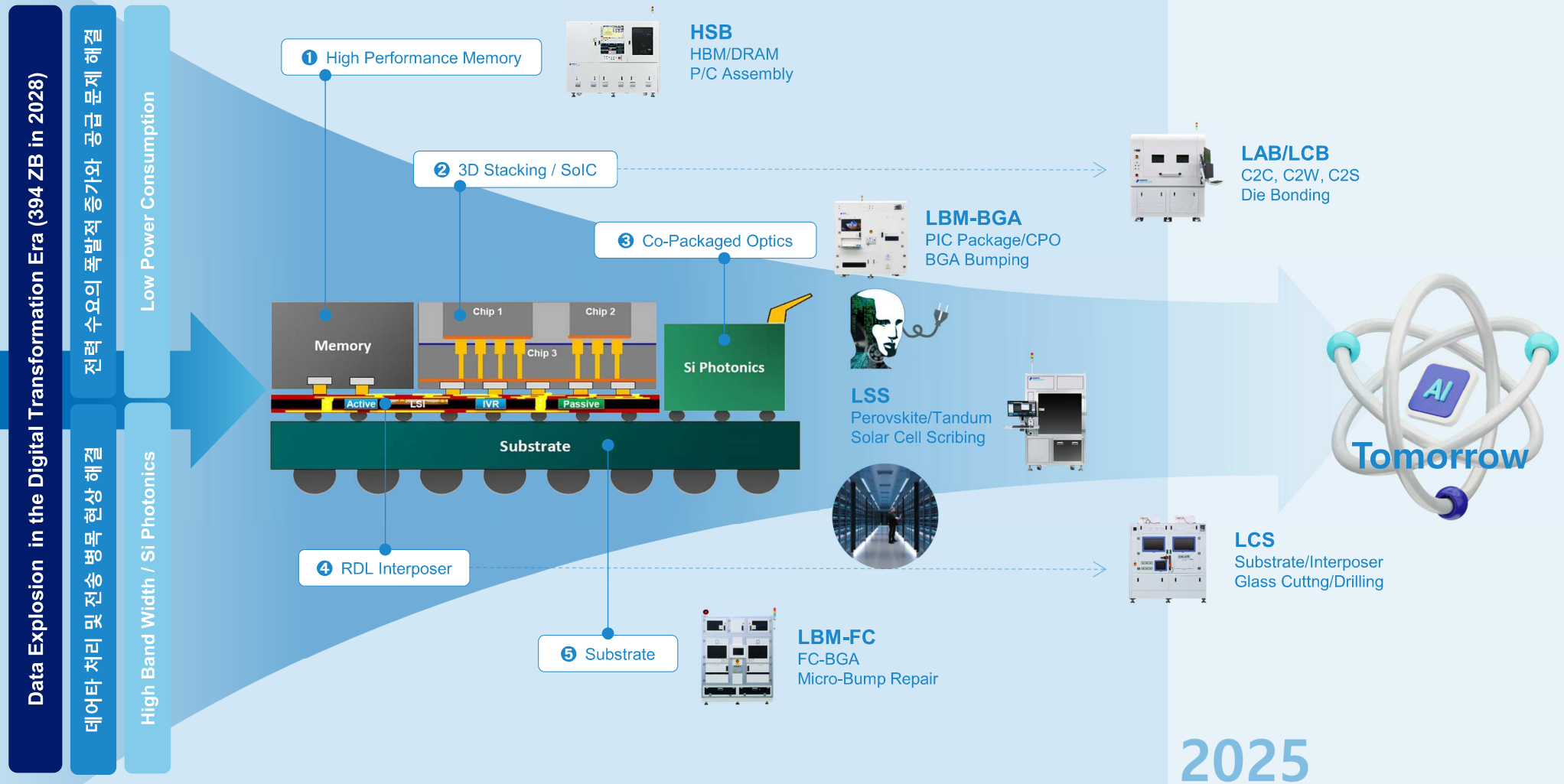
내수/수출 비중 추이

■ 내수 ■ 수출

(단위: %)



AI Platform 고도화를 위한 첨단 공정 및 제품 로드맵



Fact Sheet

2025년.1Q

- 실적 요약

- 요약 재무제표

DAWON
NEXVIEW

GLOBAL TOP
LASER MICRO-PROCESS
SOLUTION PROVIDER

반도체 시장 조정 국면에 따른 일시적 성장세 둔화, 내실 경영 강화로 하반기 회복 기대

분기별 손익 요약

(단위: 백만원)

구분	2024.1Q	2024.4Q	2025.1Q	YoY
매출액	3,535	7,382	2,743	△22.4%
매출원가	2,666	5,213	2,045	△23.3%
매출총이익	869	2,168	698	△19.7%
(%)	31.7%	29.4%	25.4%	△6.3%P
판매비와관리비	432	1,014	596	38.0%
영업이익(손실)	437	1,154	102	△76.7%
(%)	15.9%	15.6%	3.7%	△12.2%P
법인세비용차감전순이익	430	1,331	105	△75.6%
법인세비용(수익)	-	83	-	-
당기순이익(손실)	430	1,248	105	△75.6%
(%)	15.7%	16.9%	3.8%	△11.9%P

2024년을 기점으로 성장 본격화...손익·재무 구조 동반 개선

요약 재무상태표

(단위: 백만원)

과 목	FY22	FY23	FY24	FY25.1Q
유동자산	5,931	11,866	21,721	22,208
비유동자산	4,651	5,024	6,298	7,427
자산총계	10,582	16,890	28,019	29,635
유동부채	24,404	12,219	11,727	13,167
비유동부채	692	887	975	1,047
부채총계	25,096	13,106	12,702	14,214
자본금	459	631	801	801
기타불입자본	4,145	22,156	37,754	37,754
이익잉여금	(19,118)	(19,004)	(23,238)	(23,134)
자본총계	(14,514)	3,783	15,317	15,421

*K-IFRS 기준

요약 손익계산서

(단위: 백만원)

과 목	FY22	FY23	FY24	FY25.1Q
매출액	10,991	10,654	18,702	2,743
매출원가	7,750	8,658	13,891	2,045
매출총이익	3,241	1,996	4,811	698
판매비와관리비	2,468	2,637	3,532	596
영업이익	773	(641)	1,279	102
영업외수익	9,923	1,210	403	57
영업외비용	928	423	5,846	54
법인세비용차감전순이익	9,768	146	(4,164)	105
법인세비용	(158)	57	(22)	-
당기순이익	9,926	89	(4,142)	105

*K-IFRS 기준